

Title (en)

Mechanical process for forming metallic substrates painted by cathodic electrophoresis.

Title (de)

Verfahren zur Verformung von metallischen Substraten, die mit kathodisch abgeschiedenen Elektrottauchlacken lackiert sind.

Title (fr)

Procédé pour le formage mécanique des substrats métalliques peints par électrophorèse cathodique.

Publication

**EP 0436880 A1 19910717 (DE)**

Application

**EP 90124523 A 19901218**

Priority

DE 3942921 A 19891223

Abstract (en)

[origin: US5140835A] A process for shaping a metal substrate lacquered by a cathodic electro dip process and then baked, involving heating the lacquered and baked substrate to a temperature between a lower limit of from about 30 DEG C., suitably 20 DEG C., below the glass transition temperature of the lacquer and an upper limit of just below the decomposition temperature thereof, and then shaping the coated and baked substrate in the thus heated state. Shaping of the lacquered, baked substrate is suitably carried out by rolling, pressing, crimping, or dimpling.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren zur Verformung von metallischen Substraten, die mit kathodisch abgeschiedenen Elektrottauchlacken lackiert sind, bereitgestellt, bei dem Risse und Abplatzungen im Lack vermieden werden. Bei der mechanischen Verformung kathodisch elektrottauchlackierter metallischer Substrate wird die Oberfläche des lackierten Gegenstands auf eine Temperatur erwärmt, die über einem Wert von 30 °C unter der Glasübergangstemperatur des eingebrannten Lacks liegt, worauf die Verformung bei dieser Temperatur erfolgt.

IPC 1-7

**C25D 13/22**

IPC 8 full level

**C25D 13/00** (2006.01); **C09D 5/44** (2006.01); **C25D 13/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25D 13/22** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

[A] FR 1355201 A 19640313 - BRITISH IRON STEEL RESEARCH

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**DE 3942921 C1 19910131**; EP 0436880 A1 19910717; JP H04214897 A 19920805; US 5140835 A 19920825

DOCDB simple family (application)

**DE 3942921 A 19891223**; EP 90124523 A 19901218; JP 41827090 A 19901225; US 63202890 A 19901221